

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告及鉴证报告



## 对募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2026)第 0089 号

(第一页, 共二页)

有研半导体硅材料股份公司董事会:

我们接受委托, 对有研半导体硅材料股份公司(以下简称“有研硅”)关于 2025 年度的年度的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

有研硅管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》编制, 在所有重大方面如实反映了有研硅 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取合理保证。

## 对募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2026)第 0089 号

(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》编制, 在所有重大方面如实反映了有研硅 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》编制, 并在所有重大方面如实反映了有研硅 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供有研硅按照上述规定的要求在 2025 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2026 年 3 月 25 日



注册会计师

注册会计师



汪超



张建隆

## 有研半导体硅材料股份公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日签发的证监许可[2022] 2047 号文《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》，有研半导体硅材料股份公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股 187,143,158 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.91 元，募集资金总额为人民币 1,854,588,695.78 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,663,967,265.37 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 11 月 7 日到位，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具毕马威华振验第 2201588 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司以前年度已累计使用募集资金人民币 1,000,563,619.63 元，本年度使用募集资金人民币 198,355,293.32 元。募集资金余额为人民币 521,803,898.89 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，募集资金专项账户余额为人民币 71,803,898.89 元，与募集资金余额相差人民币 450,000,000.00 元均为未到期的现金管理余额。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金专项账户年初余额	158,569,195.04
减：本年度投入募集资金总额	198,355,293.32
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	(1,407,629.89)
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	(100,000,000.00)
加：本年度对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	10,182,367.28
募集资金专项账户年末余额	71,803,898.89

## 有研半导体硅材料股份公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2025 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 北京航天城支行	0200302619100012252	活期存款	933,851.32
招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	110907342310257	活期存款	1,842,503.78
中国民生银行股份有限公司 北京东单支行	637336316	活期存款	28,466,410.84
上海浦东发展银行股份有限公司 北京知春路支行	91170078801400002732	活期存款	8,165,157.78
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	活期存款	32,395,975.17
合计			71,803,898.89

本公司根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采取专户存储管理，开设募集资金专户，并于 2022 年 11 月 1 日与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户的监管银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 11 月 1 日，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户的监管银行上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司(及子公司)、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、管理与使用募集资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，2025 年度本公司募投项目的资金使用情况，详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### 2. 募投项目先期投入及置换情况

本公司 2025 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，于 2024 年 10 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-050)。于 2025 年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-039)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，未到期部分情况如下：

单位：人民币元

签约银行	产品名称	收益类型	余额	起止日期	是否赎回
中信银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	150,000,000.00	2025.12.18-2026.03.20	否
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	250,000,000.00	2025.12.24-2026.03.26	否
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	结构性存款	浮动收益	50,000,000.00	2025.12.31-2026.03.26	否
合计			450,000,000.00		

#### 5. 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2025 年度不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

本公司 2025 年度不存在用超募资金归还银行贷款情况。

#### 6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

于 2025 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意将部分超募资金人民币 4,833 万元用于 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化。具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-029)。

本公司 2025 年度不存在将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

#### 7. 节余募集资金使用情况

本公司 2025 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 8. 募集资金使用的其他情况

本公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### 1. 变更募集资金投资项目情况

于 2025 年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》，同意本公司将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金人民币 11,922 万元(占实际募集资金净额的 7.16%)用于新建“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”，并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》(公告编号：2025-035)。

本公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况，详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

##### 2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中信证券股份有限公司作为本公司首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，出具《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》结论性意见如下：

经核查，保荐机构认为：本公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在违规使用募集资金的情形。

有研半导体硅材料股份公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司 2025 年度不存在两次以上融资的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 3 月 25 日

有研半导体硅材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

募集资金总额(注1)		1,663,967,265.37					本年度投入募集资金总额		198,355,293.32				
变更用途的募集资金总额		119,220,000.00					已累计投入募集资金总额		1,198,918,912.95				
变更用途的募集资金总额比例		7.16%											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	66,834,670.16	247,814,701.35	(10,013,398.65)	96.12	不适用	不适用	不适用	不适用	
集成电路用8英寸硅片扩产项目(注5)	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	84,775,561.23	338,327,243.15	(46,497,056.85)	87.92	2025年12月	不适用	不适用	否	
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	有	357,347,600.00	238,127,600.00	238,127,600.00	43,058,780.13	188,154,999.06	(49,972,600.94)	79.01	2026年12月	不适用	不适用	否	
集成电路用8英寸硅片再扩产项目	无	-	119,220,000.00	119,220,000.00	770,281.80	770,281.80	(118,449,718.20)	0.65	2026年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	195,439,293.32	775,067,225.36	(224,932,774.64)	77.51	—	—	—	—	
超募资金永久补充(注2)	无	不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	-	385,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
股份回购(注2)	无	不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	-	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化(注2)	无	不适用	48,330,000.00	48,330,000.00	2,916,000.00	2,916,000.00	(45,414,000.00)	6.03	2026年12月	不适用	不适用	否	
合计	—	1,000,000,000.00	1,469,265,687.59	1,469,265,687.59	198,355,293.32	1,198,918,912.95	(270,346,774.64)	81.60	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)(注4)				详见“四、1 变更募集资金投资项目情况”及注4									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见“三、4 对闲置募集资金进行现金管理情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况				详见“三、6 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况”									
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况				本年度不存在募集资金使用的其他情况									

有研半导体硅材料股份公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注2：截至 2025 年 12 月 31 日止，超募资金总额 663,967,265.37 元，其中 385,000,000.00 元用于永久补流，35,935,687.59 元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购，2,916,000.00 元用于 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目。

注3：由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注4：未达到计划进度原因主要基于以下因素：第一，受市场需求变动的影 响，本公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二，本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则，本公司适当调整了投资节奏。“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”已于 2025 年 12 月结项，本公司 8 寸硅片产能已达到 25 万片/月。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响，加之贸易战导致刻蚀材料出口下滑，本公司经过审慎研究，决定对该项目进行调整。

注5：“集成电路用 8 英寸硅片扩产项目”已于 2025 年 12 月结项，截至期末投入进度为 87.92%，系部分尾款尚未结清等。

有研半导体硅材料股份公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表:

金额单位: 人民币元

发行名称		2022年首次公开发行股份募集资金														
募集资金到账日期		2022年11月7日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	生产建设	山东有研半导体材料有限公司	山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号	238,127,600.00	238,127,600.00	43,058,780.13	188,154,999.06	79.01	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年10月27日	2025年11月12日	
集成电路用8英寸硅片再扩产项目	集成电路用8英寸硅片再扩产项目	生产建设	山东有研半导体材料有限公司	山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号	119,220,000.00	119,220,000.00	770,281.80	770,281.80	0.65	2026年12月	不适用	不适用				
合计					357,347,600.00	357,347,600.00	43,829,061.93	188,925,280.86	—	—	—	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					于2025年10月27日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》,基于当前市场环境的深入分析,结合本公司发展战略,同意本公司将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金人民币11,922万元(占实际募集资金净额的7.16%)用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”,并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见本公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》(公告编号:2025-035)。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响,开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响,加之贸易战导致刻蚀材料出口下滑,本公司经过审慎研究,决定对该项目进行调整。											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用											